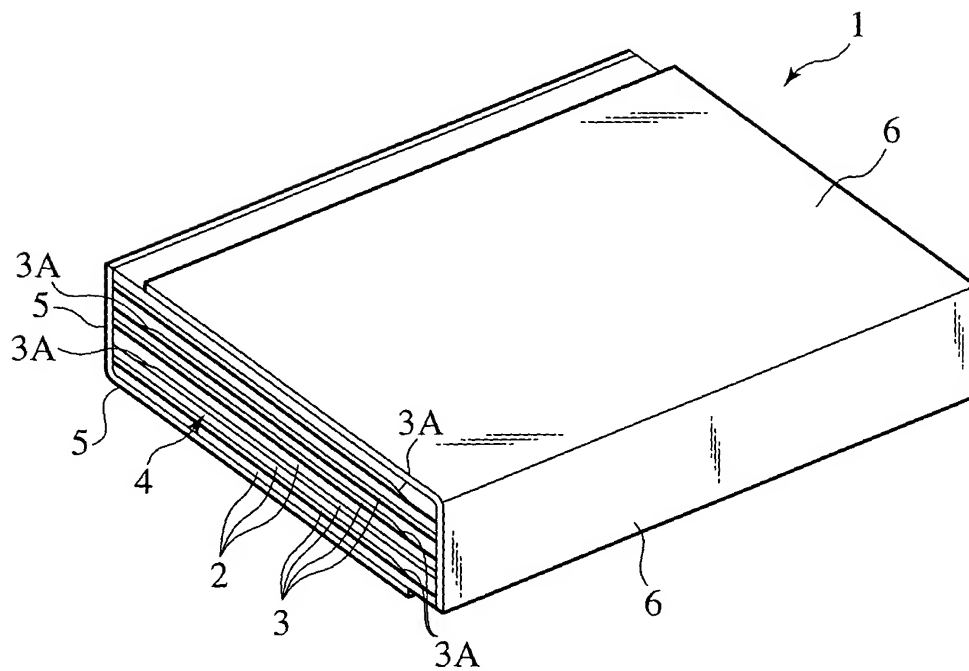


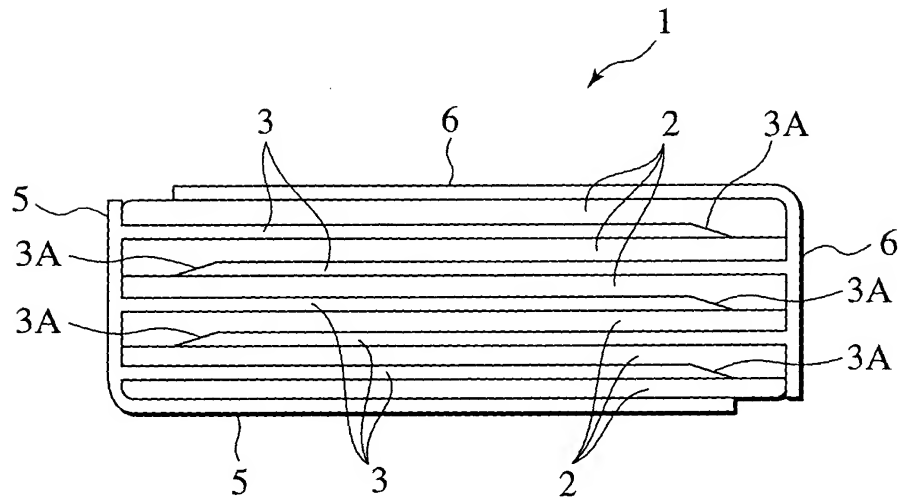
1/7

FIG. 1



2/7

FIG.2



3/7

FIG.3

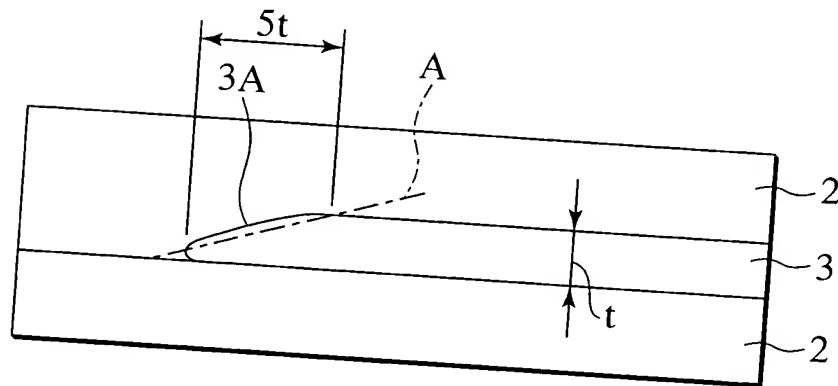
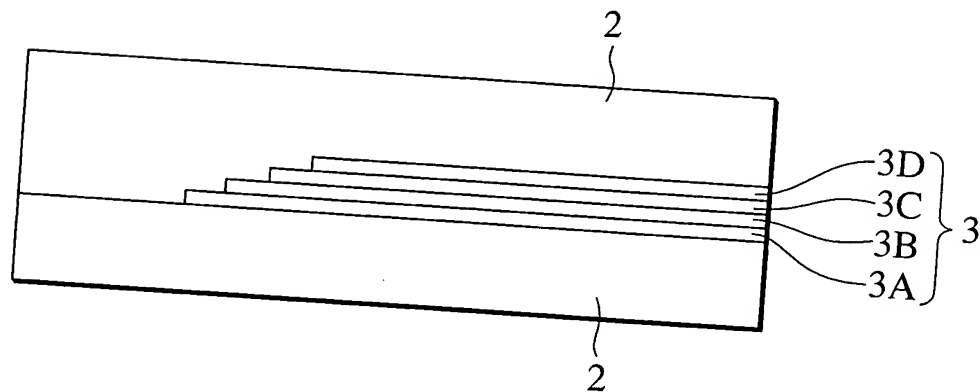
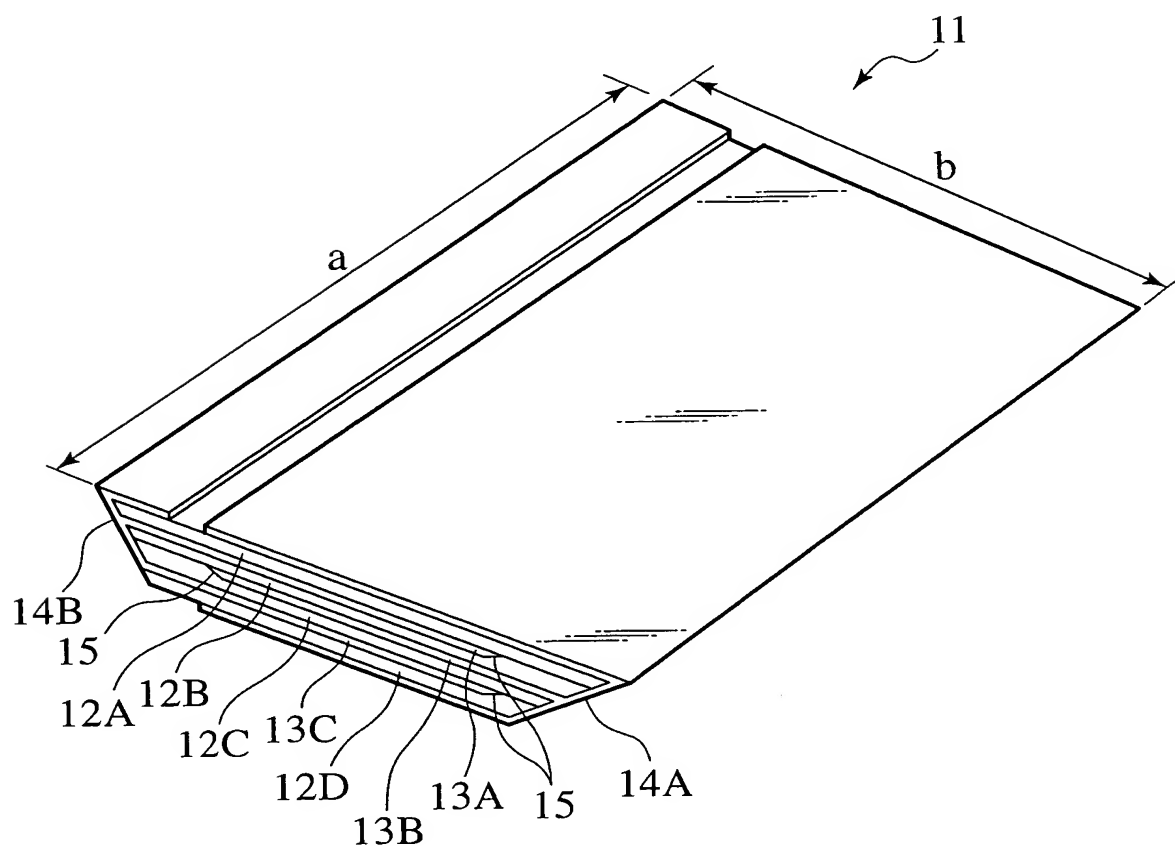


FIG.4



4/7

FIG.5



5/7

FIG.6

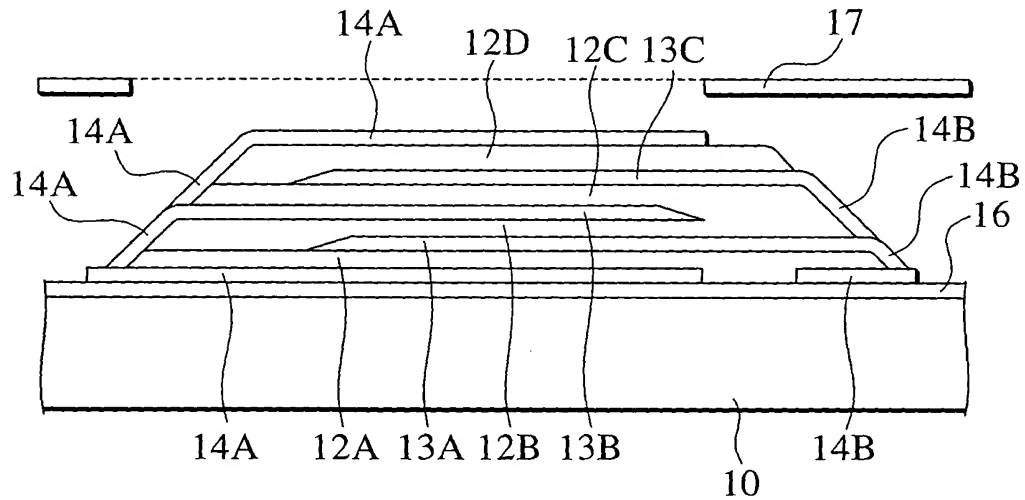
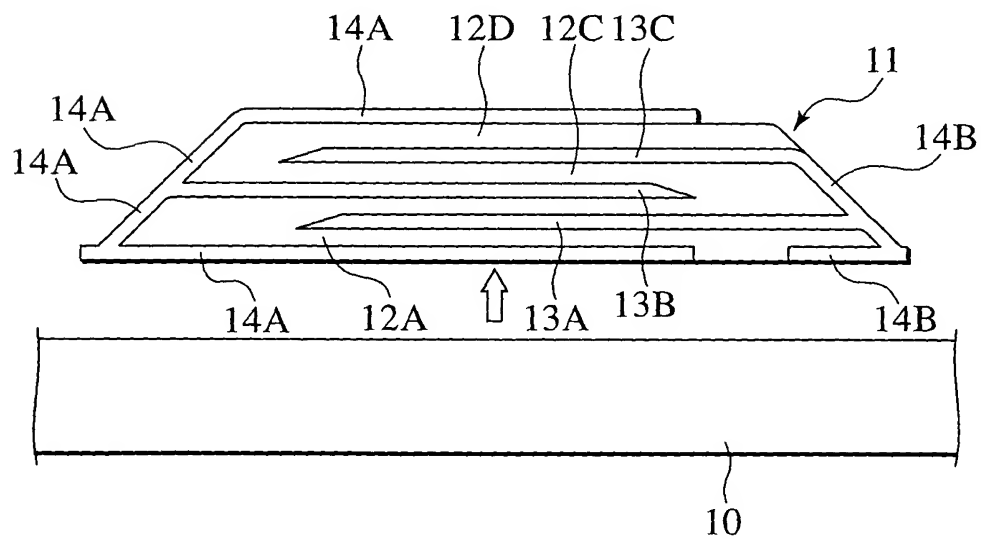


FIG.7



6/7

FIG.8

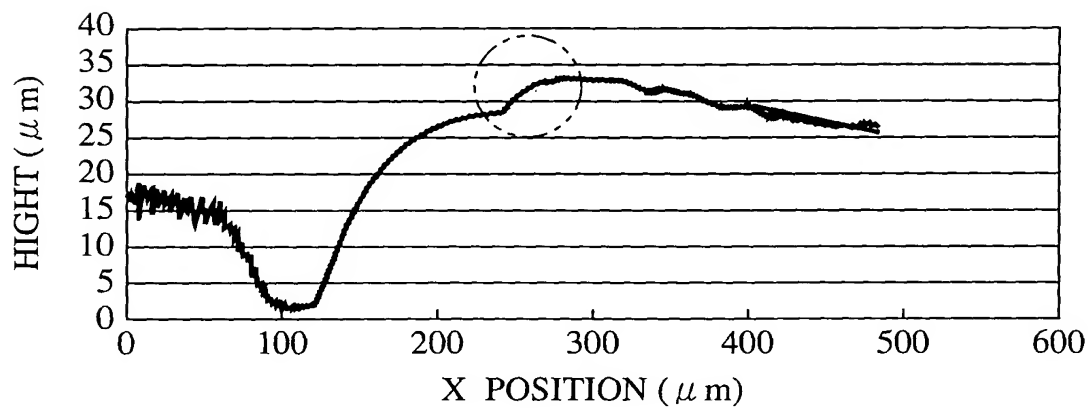
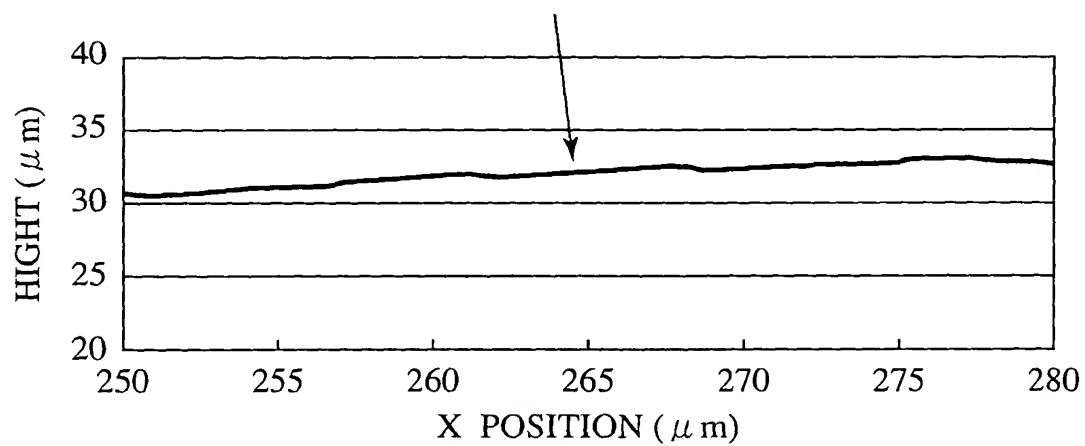


FIG.9



7/7

FIG.10

電極ペースト 平均粒径 ( $\mu\text{m}$ )	電極ペースト バインダー 部数 (wt%)	電極ペースト 溶剤部数 (wt%)	電極ペースト 粘度 (Pa · sec)	セラミック 未焼成 層の表面粗さ (Ra, $\mu\text{m}$ )	電極角度 (deg.)
0.050	5.0	10	4200	0.3	35
4.5	5.0	10	50	0.3	1.7
1.5	5.0	25	25	0.3	1.4
1.5	5.0	4.0	3300	0.3	33
1.5	5.0	10	300	0.3	14
1.5	0.7	10	32	0.3	1.8
1.5	12	10	3100	0.3	32

FIG.11

圧電/電歪ペースト		セラミック 未焼成 層の表面粗さ (Ra, $\mu\text{m}$ )	電極ペースト 粘度 (Pa · sec)	電極角度 (deg.)
粉末メジアン径 ( $\mu\text{m}$ )	バインダー部数 (wt%)			
0.050	5.0	0.090	300	5.0
5.2	5.0	0.60	300	31
0.50	31	0.060	300	3.0
0.50	0.4	0.70	300	33
0.50	5.0	0.10	300	6.0
0.50	5.0	0.60	300	32